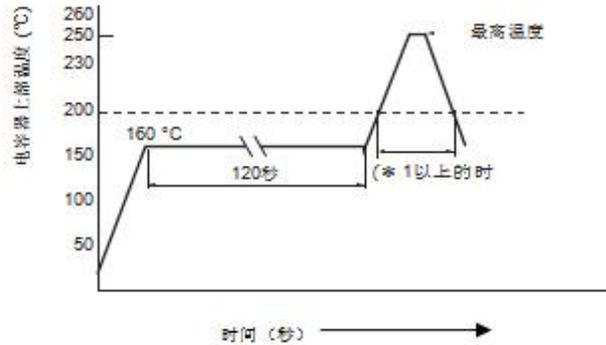


贴片型回流焊条件

1. 无铅回流焊使用条件



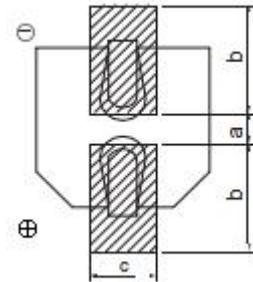
产品尺寸 (Φ)		Φ4~Φ6.3	Φ4~Φ6.3	Φ8~Φ18	≥12.5
额定电压 (v)		4~50	≥63	4~100	≥160
预热	温度 (°C)	150~180			
	时间(S) (最大)	120		100	
持续	温度	230	217	230	217
	时间(S) (最大)	30	60	40	40
最高温度	温度 (°C)	250	250	250	240
附近时间	时间(S)	5			
回流焊次数		1		≤2	

注：回流焊方式请使用红外线，热风并用，大气等气体介质热传导方式。

2. 焊盘型式与适用产品尺寸

用于片式电容器的电路板的焊盘图案请参考下述焊盘尺寸，进行电路设计。特别是由于焊盘间距会影响安装强度，因此，请务必仔细确认。

产品尺寸	焊盘尺寸 (mm)		
	a	b	c
4Φ	1.0	2.6	1.6
5Φ	1.4	3.0	1.6
6.3Φ	1.9	3.5	1.6
8Φ	3.0	3.5	2.5
10Φ	4.0	4.0	2.5
12.5Φ	4.0	6.0	3.2



3. 焊接方法之适用性

焊接方法	回流焊	烙铁	波峰焊
适用性	适用 √	适用 √	不适用 X

4. 回流焊试验方法如下

- ①产品于焊接时请依用之温度条件，如使用较高之温度时，请量测并告知电容温度及回流焊条件；
- ②制品尺寸较大其上升的温度较缓慢，并非得依制品尺寸别调整回流焊锡炉的温度。

例如：4Φ~12.5Φ产品皆会安装于PCB板过锡炉。

5. 焊锡注意事项

(1) 回流焊接温度的相关因素

- ①产品尺寸：产品尺寸较大其温度上知较缓慢；

②制品安装位置：PCB 中心的温度较 PCB 边缘温度低。

(2) 反复回流焊

①如果非必要，请避免产品进行二次回流焊；

②如果反复回流是不可避免的，请量测第一/二次的回流温度/时间，二次回流温度需冷却至 5-35℃。

(3) 以铬铁焊锡时请依循下列条件作业

①铬铁最高温度：350±5℃；

②焊接时间：3 +1/-0 秒。